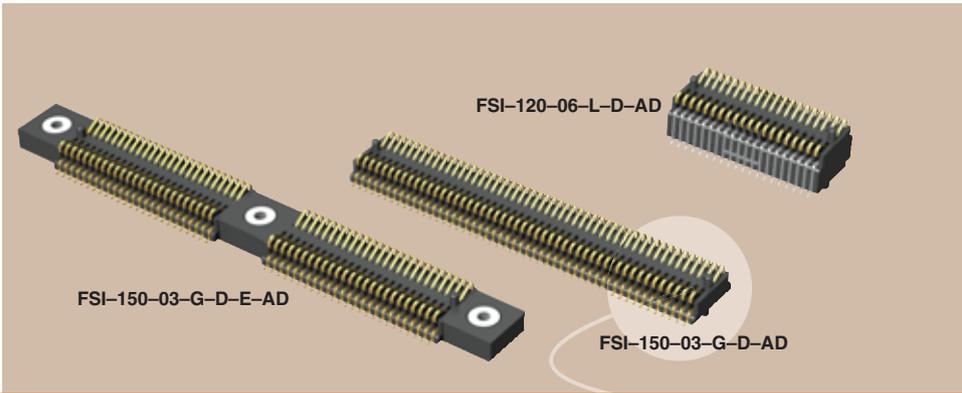


(1,00mm) .03937"

FSI 系列



薄型与加高的一件式

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局，请浏览 www.samtec.com?FSI

绝缘体材料：
液晶聚合物



触点材料：
镀铜

额定电流：
环境温度 80°C 时 1A
工作温度范围：
-55°C 至 +125°C

电镀：
50μ" (1.27μm) 的镍底上镀金
符合 RoHS 规范要求：
是

加工：
可无铅焊接：
是

SMT 引线共面度：
最大 (0.10mm) .004" (05-35)
最大 (0.15mm) .006" (40-50)
压缩板：
需要镀金焊点

特殊应用选项

公制插件、无定位针、
顶部定位针和底部定位针。
请致电 Samtec。

板堆叠厚度选项

(1,00mm)
.03937"

短型或可选的螺纹插件



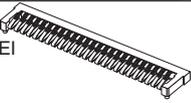
• 螺纹插件选项

注：如应用需要 40-50 个无螺纹插件的位置，请联系 Samtec 互联加工小组。

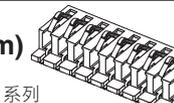
注：有些长度、式样和选项为非标准型，不可退换。

还提供

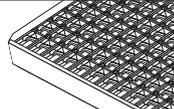
薄型
请参见 SEI 系列。



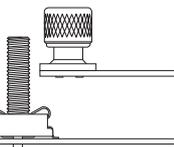
.100"
(2,54mm)
间距
请参见 SIB 系列



高密度
请参见 GFZ 系列。



柔性数据链路
请参见 FSIF 系列。



FSI

1

每排引脚数

主体高度

电镀选项

10, 20, 30, 40 与 50
(插件/螺丝选项)

05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
(短型)

-03
= 3,00mm

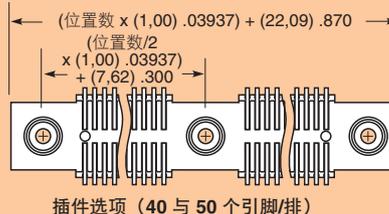
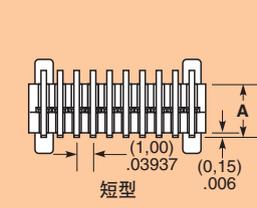
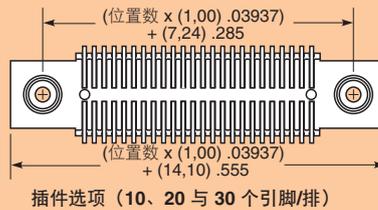
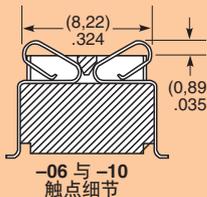
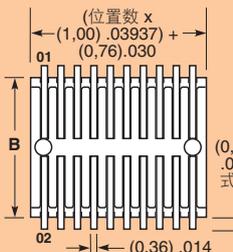
-06
= 6,00mm

-10
= 10,00mm

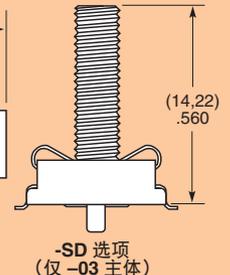
-G
= 镀 10μ" (0.25μm) 的金 (仅 -03)

-L
= 触点镀 10μ" (0.25μm) 的金，焊尾镀雾锡 (不适用于 -03 的主体高度)

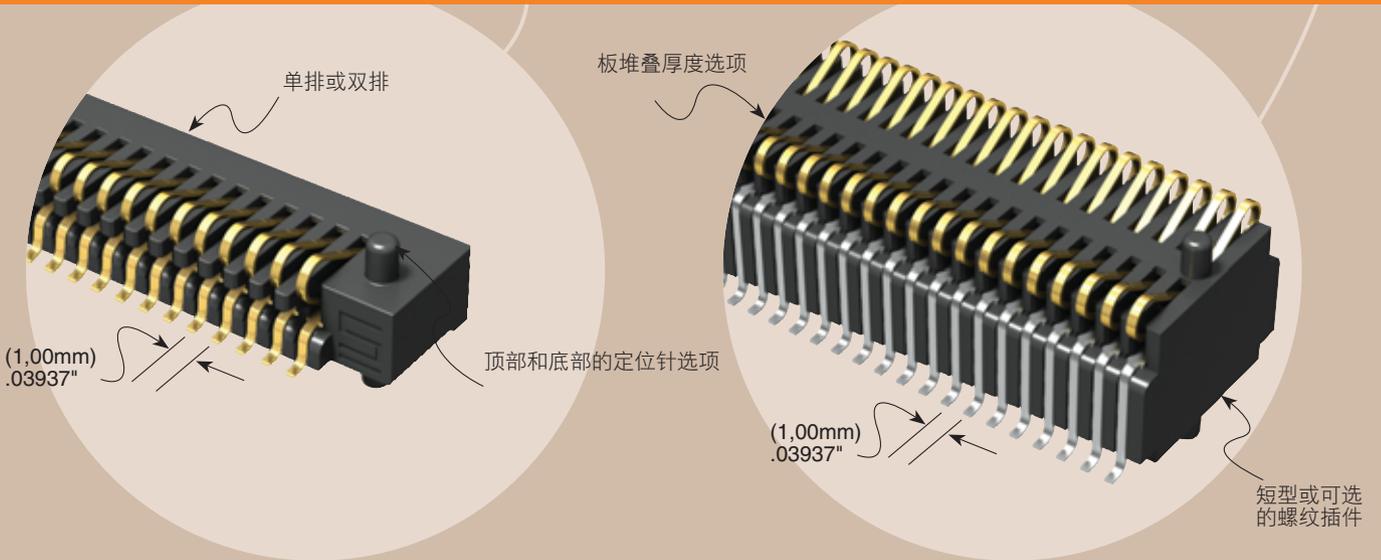
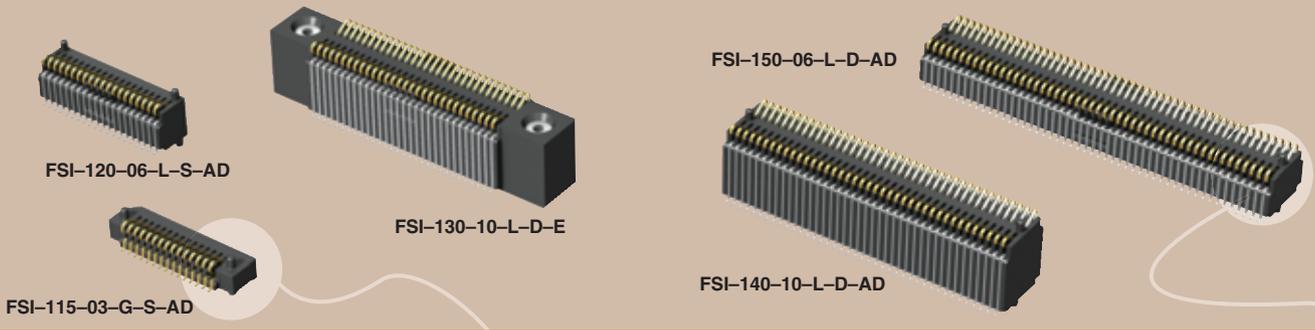
注：提供其他镀金选项。请联系 Samtec。



主体高度	A	B
-03	(3,00) .118	(8,76) .345
-06	(6,00) .236	(9,02) .355
-10	(10,00) .394	(9,02) .355



双排型 -03, -06, -10



排选项

- S = 单排
- D = 双排

螺丝选项

- 短型留空 (无螺丝固定插件或孔)
- E = #2-56 x 1/16" 螺丝螺纹 (不提供 -SD)

定位选项

- 无定位针时留空
- AD = 顶部和底部的定位针

其他选项

- SD = 螺丝固定 (用于配接 FSIF 系列柔性数据链路) (仅 10, 20, 30 个位置) (不提供螺纹插件选项) (不适用于 -S 排选项或 -10 主体高度)
- WT = 焊片 (仅适用于 -S 排选项与 -06 与 -10 主体高度)
- K = 聚酰亚胺薄膜取放垫 (仅 40 与 50 位置提供螺纹插件选项)
- P = 塑料取放垫 (5,08mm) .200" x (12,45mm) .490" (40 与 50 不适用于 -E) (不适用于 -S 排选项或 -03 主体高度)
- TR = 卷带封装

